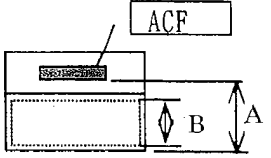
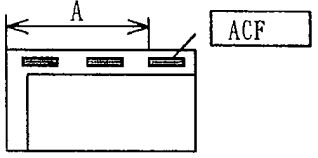


2. 仕様

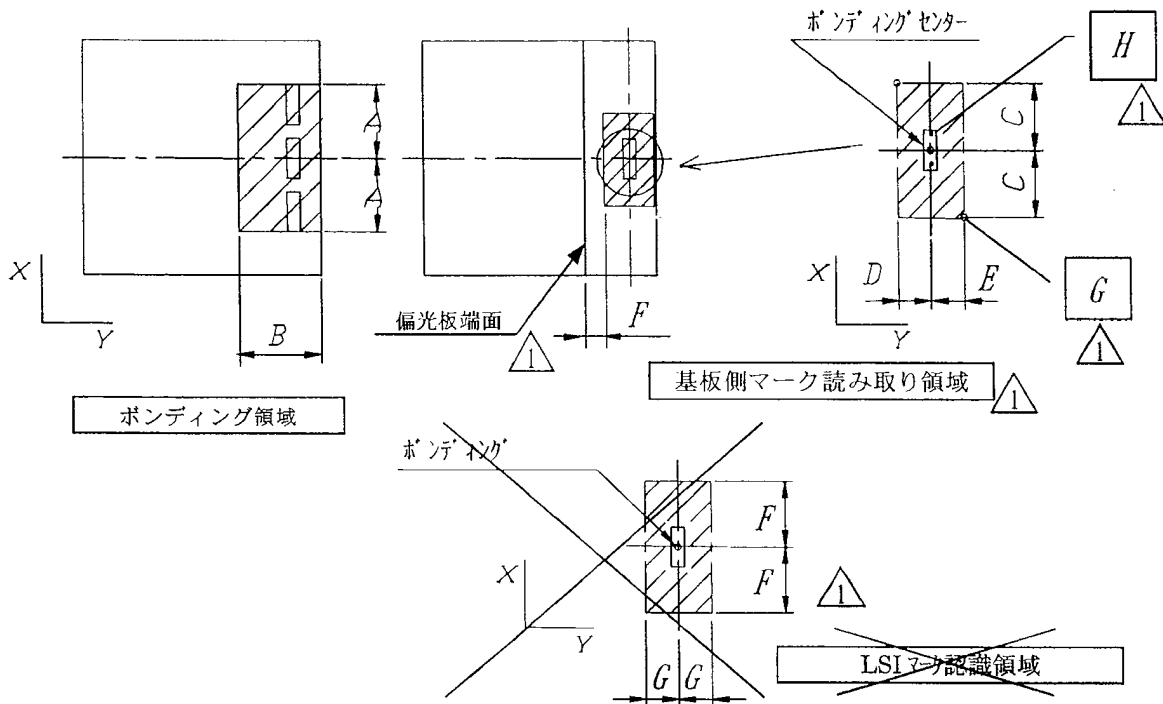
2-1. ワーク仕様

1	基板	サイズ 単位：mm	2枚搬送時 MIN. 20(L) × 20(W) MAX. 165(L) × 120(W) t=0.4×2~1.1×2	搬送に影響ある寸法ばらつき、ソリ なきこと 下図のA寸法は13mm以上のこと。 下図のB寸法は7mm以上のこと。 
		材質	ガラス (LCD)	LCDの対角寸法が320mm以下のこと
2	ACF	サイズ	幅 1~6mm 貼付長さ 5~22mm リール外形 MAX. φ160mm	ACF幅は1から6mmまでの間の範 囲内で調整できます ACF貼付長さはパラメータで設定でき ます。 オプションの圧着ブロックに変更 する事により貼付長さを65mmまで 対応することが出来ます。 但し、下図A寸法が100mmを超え ると、上流ヘッドが下流基板と干渉す るためACF転写出来ません。 
		種類	1種類	
		搭載数	1 ~ 32/基板	1辺当たりのACF転写数は最大16 ポイントです。
		対応メーカー	日立ケミカル(株) ソニーケミカル(株)	
3	チップ	サイズ 単位：mm	MIN. 4L × 1W MAX. 20L × 5W T=0.4~0.8mm	オプションの32mmヒーターに変更 する事により28(L) × 5(W)まで 実装可能です。
		種類	2種類	
		搭載数	1 ~ 32/基板	1辺当たりのLSI搭載数は最大16 個です。 但し、本圧着部の本圧着動作は1辺 当たり最大8回です。
		供給方向	フェイスアップ または フェイスダウン	
		トレイ	2インチ、3インチ及び4インチワッフルトレイ	ポケット内チップのクリアランス は、+0.2mm以内。

*ワーク寸法により、治具交換が必要な場合があります。

2-2. ボンディング領域と推奨マーク (仮圧着部用)

1) P 社とLSIのアライメント用推奨マーク




2 枚搬送時

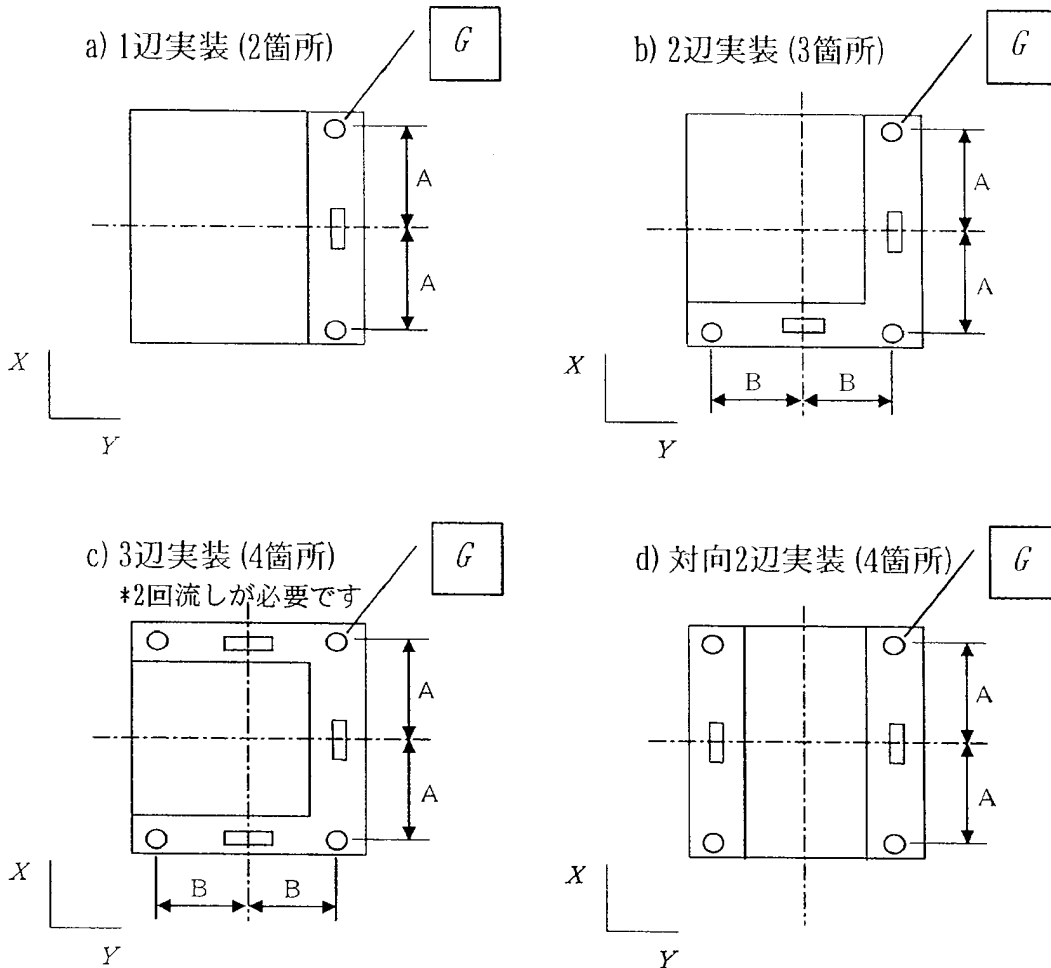
ボンディング領域 (X)	A	82.5 mm
ボンディング領域 (Y)	B	Max 10 mm
基板側マーク読み取り領域 (X)	C	15 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y-)	D	Max. 2.5 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y+)	E	Max. 8.5 mm
偏光板端面と基板側マーク読み取り領域の間隔 (Y)	F	Min. 2.5 mm
基板マーク：接着材の外側、黒地に白丸2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変形が、視野内にないこと。)	G	φ0.1 mm
チップマーク：2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変化が、視野内にないこと。)	H	φ0.1 mm

1 枚搬送時

ボンディング領域 (X)	A	137.5 mm
ボンディング領域 (Y)	B	Max 10 mm
基板側マーク読み取り領域 (X)	C	15 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y-)	D	Max. 2.5 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y+)	E	Max. 8.5 mm
偏光板端面と基板側マーク読み取り領域の間隔 (Y)	F	Min. 2.5 mm
基板マーク：接着材の外側、黒地に白丸2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変形が、視野内にないこと。)	G	φ0.1 mm
チップマーク：2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変化が、視野内にないこと。)	H	φ0.1 mm

2) パネル搬送用推奨マーク（拭き取り部、ACF部）

パネル搬送アライメント用に下記のアライメントマークが必要です。 



2枚搬送時

基板側マーク読み取り領域 (X)	A	Max. 82.5 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y)	B	Max. 80 mm
基板マーク：接着材の外側、黒地に白丸2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変形が、視野内にないこと。)	G	φ0.5 mm

1枚搬送時

基板側マーク読み取り領域 (X)	A	Max. 137.5 mm
基板側マーク読み取り領域 (Y)	B	Max. 80 mm
基板マーク：接着材の外側、黒地に白丸2カ所 (認識に支障が出る、汚れ、傷、表面付着物、色の 変形が、視野内にないこと。)	G	φ0.5 mm